TG669V3

训推一体AI服务器



TG669V3是一款兼具训练和推理的具有广泛用途的6U8卡AI服务器，基于AMD 9004/9005处理器平台，支持业界多种主流AI加速卡，具备性能卓越、架构灵活、扩展性强、配置丰富和可靠性高等特点，适用于AI训练&推理、人工智能、高性能计算、数据分析等应用场景。

全新平台 卓越性能

- 支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005 系列处理器，TDP 500W，计算性能强劲；
- 支持10张双宽GPU，最高 TDP 600W，每张卡支持 PCIe 5.0 x16，提供极致异构算力；
- 支持PCIe Switch x32上行，支持Fabric高效互联，充分发挥GPU算力；
- 支持24个DDR5内存，最高速率6400MT/s，提供大容量高速内存空间；

架构灵活 配置丰富

- 支持直通和 Switch 两种架构，可选多达7种 GPU 拓扑，灵活匹配不同应用场景需求；
- 超高扩展能力，支持最多15个标准 PCIe 插槽+1个OCP 3.0网卡插槽；

极致散热 高效供电

- 散热极致优化，满足600W被动GPU散热要求
- 电源供电优化，支持PSU N+N冗余

稳定可靠 智能管理

- 系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，提升故障维护效率，提升系统的可用性；
- 集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持 IPMI2.0、Redfish、SNMP 等多种管理协议；
- 支持远程 KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，实现了全面的远程系统级智能管理。

技术规格

GPU互联方案	直通	PCIe Switch
产品形态	6U机架式	
CPU	支持2颗AMD EPYC™ 9004/9005 系列处理器，TDP 500W	
GPU	支持最多8张双宽GPU, 最高TDP 600W	支持最多10张双宽GPU, 最高TDP 600W
内存	支持24个DDR5内存插槽，RDIMM&3DS RDIMM，速率最高6400MT/s	
存储控制器	可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID卡	
本地存储	支持最多12个3.5”硬盘（兼容 2.5”） 支持最多4个U.2 NVMe SSD 支持1个M.2（PCIe 3.0 x4 , 2280&22110）	支持最多12个3.5”硬盘（兼容 2.5”） 支持最多8个U.2 NVMe SSD 支持1个M.2（PCIe 3.0 x4 , 2280&22110）
PCIe扩展	支持最多11个PCIe 5.0标准插槽 可选1个OCP 3.0 网卡，PCIe 5.0 x8	支持最多13个PCIe 5.0标准插槽 可选1个OCP 3.0 网卡，可选PCIe 5.0 x8/x16 可选2个内置 PCIe 4.0标准插槽(for RAID 卡)
I/O端口	前置：2 个 USB 3.0 ， 1 个VGA 接口 后置：1个串口，2个USB 3.0接口，1个VGA接口，1个RJ45管理口	
管理功能	支持1个1Gbps RJ45专用管理口 集成BMC管理芯片AST2600，支持IPMI 2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能	
安全性	可选TPM/TCM 安全模块，机箱开盖入侵检测，加锁机箱上盖板（免工具） 支持BMC 双flash冗余设计;	
电源	可配置6/8个CRPS 电源模块，支持热插拔，支持 3+3 冗余模式; 可选2000W/2700W/3200W/3600W	
风扇	15个8056风扇，支持N+1冗余，支持热插拔; 可选配后置风扇模组;	
机箱尺寸	宽448mm x 高263.5mm x 深871.4mm（不含挂耳）	
工作温度	5ºC - 35ºC （无直接光照情况下）	
工作相对湿度	8% - 90% （无冷凝）	
支持操作系统	支持 Ubuntu、Red Hat Enterprise、Windows Server等主流操作系统, 具体版本请向销售人员咨询	

以业务目标为基础的数据中心解决方案

让您更充分地利用 IT 和企业解决方案，帮助降低 IT 复杂性、削减成本并提高效率。我们利用您当前技术的同时将针对您的需求量身定制的创新技术无缝地融入进来，以您应用的业务为基础，为您构建高效，敏捷，开放，智慧的数据中心软硬件一体解决方案，简化您的 IT，解决您的业务难题，并持续为您创造价值。有关详情，请与您的销售代表联系。

有关详细信息，请访问 www.ttyinfo.com

本文档中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。同泰怡声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。同泰怡保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。

深圳市同泰怡信息技术有限公司